高圧キセノンガスTPCにおける高精細飛跡 再構成のためのキセノンイオン検出効率 向上にかかる研究

品川響

東北大学 理学研究科 物理学専攻 素粒子実験加速器研究室 2022年1月31日

ニュートリノを伴わない2重ベータ崩壊(0νββ)

- ・ニュートリノはマヨラナ粒子(粒子=反粒子)か
 ⇒標準理論を超えた物理への鍵
 宇宙の物質優勢:レプトジェネシス
 ニュートリノの軽い質量:シーソー機構
- ・ニュートリノを伴わない2重ベータ崩壊(0vββ) - ニュートリノがマヨラナ粒子であるときに起こり得る - 非常に稀な現象

大質量崩壊核・高エネルギー分解能・低背景事象環境が必要







AXEL実験

- ・高圧キセノンガスTPCを用いた0vββ探索実験
- ¹³⁶Xe崩壊核@8atm
- ELCCによるEL光読み出し
- 飛跡再構成
- ⇒大質量崩壊核・高エネルギー分解能・低背景事象環境を実現
- ELCC(Electroluminescence Light Collection Cells)
 - 電子読み出し機構
 - EL過程=電場で加速した電子の移動距離に対し線形な増幅過程
 - セル構造



$E \xrightarrow{F}_{136Xe \sim 1 ~ \gamma}$	PMT

飛跡再構成

・電子ドリフトによる飛跡再構成

- Xeシンチレーション光とEL光の検出時間差で縦位置、ELCCの検出チャンネルによって 横位置を特定することで飛跡を再構成

- •Xe⁺イオンによる飛跡再構成
- 電子と同じ原理で飛跡再構成可能
- 拡散係数 *D*_{ion}~ ¹/₁₀₀ *D*_e ⇒より精確な飛跡が得られる





Xe⁺イオン検出原理

・Xe⁺イオンをXe原子を励起するまで加速することは難しい
 ⇒イオンの衝突により金属から放出する2次電子によってEL過程を起こす
 ・オージェ中和(AN)

⇒本実験で用いたタングステン(W)、モリブデン(Mo)で発生する

2次電子放出過程

・仕事関数φの小さい金属が必要:W、Moを用いた

イオンの加速は難しく増幅しづらい + 2次電子放出過程を挟む
 ⇒安定して検出できる技術確立が必要



2次電子

金属固体

Xe⁺

Xe⁺イオン検出のセットアップ

・容積約3Lの円筒型気密容器をXeガス@1atmで満たして運用
 ・²⁴¹Am α線源によりXeシンチレーション光(イベントトリガー)とXe⁺イオンを生成
 ・上部電極とWないしMoワイヤにより形成した電場でXe⁺イオンをワイヤにドリフト
 ・Xe⁺イオンがワイヤに衝突し2次電子を放出
 ・ワイヤ近傍で集約した高電場により2次電子が発生したEL光をPMTで検出



本セットアップにおける電場強度の見積り



検出Xe⁺イオン数の見積り

 α線照射による2次電子放出数 - α線が有感領域で落とすエネルギー: 4.6MeV 10⁰ - キセノン電離過程のW値:22.1eV - 2次電子放出確率: 1%(タングステン) $4.6 MeV/22.1 eV \times 0.01 = 2.1 \times 10^{3}$ 個/event 2次電子放出確率 AXELグループの先行実験の検出数 10⁻¹ - 7.8 個/event ⇒検出効率の向上が課題 - 検出数が少ない原因の候補 ・測定や解析でのスレショルド設定 ワイヤの表面状態



2次電子1個の発光光量の見積り

・電子増幅率(なだれ増幅)M、放出2次電子1個が生成するEL光光子数Nから、2次電子1個が生じる光子数の見積り(印加電圧:-1500 V)

ワイヤ線径	電子増幅率M	EL光子数N	総光子数
Φ 20 <i>μ</i> m	32	168	5376
Φ 30 μ m	7	167	1169

⇒ワイヤ線径φ20µmからφ30µmで約5倍の光量差
 ⇒EL光子数はほぼ変わらず



本研究で行ったこと

1:ワイヤ加熱によるワイヤ表面状態の改善の試み

2:ワイヤ種別のXe⁺イオン検出効率評価

3:Xe⁺イオン検出効率の電場依存性

4:ワイヤ表面へのMgO薄膜形成による改善の試み

典型的なイベント波形

・シンチレーション光のパルス(トリガーパルス)がイベントトリガー
・1イベント=60msの中に、数~数十個のパルスが含まれる
・Xe⁺イオン1個につき1パルスとみなせる



典型的な解析手法(先行実験再現セットアップ)

トリガーパルス光量でのα線イベント選定 検出タイミングによるXe⁺イオン信号検出 ELウィンドウ内のパルスの光量



1:ワイヤ加熱のためのセットアップ変更

- ・測定前に電流印加によりワイヤを加熱したい
- ・セットアップ変更点
 - Cu電極保護ワイヤ(Moφ0.3mm)を溶接
 - PTFE→アルミナ
 - 加熱導線
 - ワイヤ抵抗測定→ワイヤ温度モニタ
 - 白金抵抗温度計→Cu電極温度モニタ
- ・耐熱の見積と加熱試験
- 右上図の放熱経路を考え平衡状態の温度を計算 ⇒問題なさそう
- アルゴン@1atm中で加熱試験
 - ⇒ワイヤ温度1300Kでワイヤ切断
 - ⇒Cu電極温度は計算値を下回り、耐熱性能確認





加熱セットアップの結果



原因特定のための測定

・2つの追加測定を行い、原因を探った

- アルミナがBGを増加 / Xe⁺イオン信号を消す原因
 アルミナを用いたランのみでBGイベント、BGパルスが増加
- ・アルミナ
- 蛍光特性:BGイベント増加?
- 高い2次電子放出係数:Xe⁺イオンを中和?
- ・ワイヤ表面汚染は、検出Xe⁺イオン数、Xe⁺イオンのパルス光量を減少させる
- ワイヤの仕事関数の変化か

⇒アルミナを用いてはならない

	アルミナブロック枚数(枚)	ワイヤ	イベントレート(Hz)	検出Xe ⁺ イオン数(pulse/ev)	Xe ⁺ イオンパルス光量(photon/pulse)	BGパルス数(pulse/ev)
先行実験再現	-	非溶接	0.0654	4.25	253	0.31
加熱セットアップ	2	溶接	0.0971	-	-	15
表面汚染ワイヤ	-	溶接	0.0650	1.04	143	0.25
アルミナ	1	非溶接	0.0773	-	-	1.1

2:ワイヤ種別のXe⁺イオン検出効率測定

- ・ワイヤ線径依存性
 - ⇒ワイヤ近傍の電場強度
 - EL増幅率
 - 電子増幅率
 - 2次電子放出確率:電場の大きさの違いによる後方散乱確率の変化
- ・ワイヤ素材による違い
 - ⇒仕事関数
 - W:4.5eV
 - Mo:4.3eV

⇒どれほど影響するか

3つのラン結果比較

ワイヤ	電場(kV/cm)	イベントレート(Hz)	シンチレーション光量(photon/pulse)	検出Xe ⁺ イオン数(pulse/ev)	Xe ⁺ イオンパルス光量(photon/pulse)	BGパルス数(pulse/ev)
W-Φ20μm	187	0.0654	1164	4.25	253	0.31
W-Φ30μm	131	0.0673	1572	0.0854	7.08	0.21
Mo-Φ30μm	131	0.0636	1489	0.396	74	0.20

W-φ20μm vs W-φ30μm

- ワイヤを太くすることにより、
- ・信号パルス数:約1/50
 - ワイヤ近傍の電場強度の違い
- ・信号パルス光量:約1/36
- 光量の違いは5倍のはず(p.9)
- -5倍以上となる理由は不明

W-φ30μm vs Mo-φ30μm

- W→Moにすることで、
- ・信号パルス数:約4.6倍
- 仕事関数の違い
- ・信号パルス光量:約10倍
 - 2次電子の運動エネルギーの違い?

3: 電場依存性測定

・印加電圧を変化させ、電場依存性を測定
 ・ワイヤ: Mo-φ30μm

電圧(V)	圧力(bar)	換算電場(kV/cm/bar)	水分量(ppm)	イベントレート(Hz)	BGパルス数(pulse/event)
-1500	1.00	131	0.69	0.0636	0.20
-1650	1.04	138	1.07	0.0661	0.27
-1800	1.19	132	2.48	0.0664	0.24
-1950	1.00	171	1.16	0.0620	0.28

検出Xe⁺イオン数(pulse/event)

- ・イベントあたりの検出Xe⁺イオン数は電場に およそ比例
- ・換算電場132(kV/cm/bar)の点は、ガス純度の悪化が検出イオン数を下げていそう
- ・換算電場171(kV/cm/bar)以上の2点はどちらが電場依存性をよく表すかは不明
- ワイヤ保存状態による悪化?
- ワイヤ線径の電場以外への影響により上昇? ⇒測定コンディションを揃えたランが必要



電場依存性 – Xe+イオンパルス光量



ワイヤ線径(μm)	電圧(V)	電子増幅(個)	EL増幅(photon)	発生光子数(個)	検出光子数(個)
Φ20	-1500	32	168	5376	253
Ф 30	-1500	7	167	1169	74
Φ30	-1950	56	227	12712	1207

4: MgO薄膜による影響

- •Mo-φ30µmワイヤに15nmのMgO薄膜を形成
 ⇒2次電子放出が上昇するという報告
- ・EL光パルス数(pulse/event)は大きく減少 ⇒原因は不明
- EL光子数(photon/pulse)は有意な影響は見られず
 ⇒コンシステント

・薄膜による2次電子放出上昇の効果は見られず





まとめ

- ・AXEL実験:0vββ探索
- ⇒大質量崩壊核・高エネルギー分解能・低背景事象環境
- ・Xe⁺イオンによる飛跡再構成を目指す
- •Xe⁺イオン検出効率の向上が課題
- ・ワイヤ加熱(ワイヤ表面汚染の除去)のセットアップ
 - ⇒耐熱のために用いたアルミナが原因でXe+イオン信号が見えず
 - ⇒加熱の影響は未測定
- ・ワイヤ線径依存性(ワイヤ近傍の電場強度)
 - ⇒太いワイヤ(W-φ30µm)の方が検出効率が低い
- ・ワイヤ素材(仕事関数(W、Mo))
 - ⇒仕事関数の小さいワイヤ(Mo)の方が検出効率が高い

•電場依存性

- ⇒電場強度が大きい方が検出効率が高い
- ・MgO薄膜ワイヤ(2次電子放出が高いとされる) ⇒検出効率が下がった・さらなる測定が必要
- ・測定コンディションを整える技術確立が必要

		検出Xe ⁺ イオン数
ワイヤ線径	$\Phi 20 \mu \mathrm{m} \rightarrow \Phi 30 \mu \mathrm{m}$	1/50
ワイヤ素材	W→Mo	4.6倍
換算電場(kV/cm/bar)	131→171	3.2倍

Back Up

ガス系統



- ・陽イオン衝突による2次電子放出
- キネティック放出
- ポテンシャル放出
 - ・共鳴中和(RN) オージェ脱励起(AD)
 - ・オージェ中和(AN) ⇒W、Moで発生する過程



2次電子1個の発光光量の見積り

・電子増幅率(なだれ増幅)M

$$\begin{split} M &= exp \int_{r}^{R} pAe^{-\frac{Bp}{E}} dx & \text{M: 電子増幅率} \\ E: 電場(V/cm) \\ p: ガス圧力(bar) \\ r: ワイヤ半径(cm) \\ R: 電極間距離(cm) \\ a: 第一電離係数 \\ \\ \Psi \dot{D} E \dot{L} \dot{D} m \frac{r}{R} x = (140\frac{E}{p} - 116)p & \text{A: } 26 \text{ Torr/cm (Xe)} \\ \Rightarrow N &= \int_{x_{t}}^{r} 140\frac{V}{\ln \frac{r}{R}} x - 116p \, dx = 140\frac{V}{\ln \frac{r}{R}} \ln \frac{x_{t}}{r} - 116p(r - x_{t}) & \text{N: } \mathcal{X} + 3 \\ x_{t} &= \frac{V}{\ln \frac{r}{R}} \frac{140}{116p} & x_{t} = \frac{V}{\ln \frac{r}{R}} \frac{140}{116p} \end{split}$$

- Xe@1atm、ワイヤφ20µm、V=-1500V で M=32、N=168個 - Xe@1atm、ワイヤφ30µm、V=-1500V で M=7、N=167個 ⇒ワイヤ線径φ20µmからφ30µmで約5倍の光量差

データ取得系

・α線シンチレーション光とXe+イオン信号の検出時間差 ~10msec
 ⇒イベントトリガーパルスと信号パルスをADCにおいては別々に取得
 ・解析でイベントを再構成



・耐熱の見積と加熱試験

- 右上図の放熱経路を考え平衡状態の温度を計算

$\frac{Q}{A} = -k \frac{dT}{dx}$:熱伝導方程式			
$\frac{\frac{Q}{Q}}{1} = h(T_W - T_\infty)$:熱伝達の式			
A	Q:熱量 (W) A:断面積 (m ²) k:熱伝導率 (W/mK) T:温度 (K)	x:ワイヤ長さ(m) h:熱伝達率 (W/m²K) T _w :物体表面温度 (K) T _w :流体温度 (K)		





・LEDで1フォトンを出力して測定 ・ポアソン分布を仮定してP(0)から計算





先行実験でのイオンEL光 と思われる信号

